

证券代码：301200

证券简称：大族数控

深圳市大族数控科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-004

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	广发证券 金信基金
时间	2024年6月4日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理、财务总监兼董事会秘书：周小东 证券事务代表：周鸳鸯
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司 2024 年一季度经营情况</p> <p>随着消费电子终端库存逐步消化，加上新能源汽车电子技术升级及 AI 服务器需求增加，下游客户的资本支出增长显著，2024 年第一季度，公司实现营业收入 75,052.04 万元，同比增长 149.08%；归属于上市公司股东的净利润 6,360.12 万元，同比增长 21.49%。</p> <p>二、公司所处行业发展情况</p> <p>PCB 是电子产品之母，是电子信息产业的基础产业，伴随着 AI 产业链、卫星通讯、汽车无人驾驶等新兴应用的兴起，行业长期来看整体延续增长态势；根据 Prismark 预测，2024 年全球 PCB 产业重归成长通道，预计全年增长幅度可达 5%，并对行业的中长期维持积极展望，预估 2023-2028 年 PCB 行业营收复合增长率为 5.4%，其中 IC 封装基板、18 层以上多层板、HDI 保持较高的增速，但受全球经济波动的影响，PCB 产业依然存在投资支出年度不</p>

平均的情况，但整体规模持续保持正向增长态势。

三、公司核心竞争力

公司始终聚焦 PCB 产业，是全球 PCB 产业专用设备布局最为广泛的企业之一，通过多项核心技术的综合运用，构建了覆盖不同细分 PCB 市场及工序的立体化产品矩阵，并持续不断完善和优化产品结构；同时创新业务发展模式，凭借广泛覆盖的客户群及良好合作关系，形成应用场景、客户、产品、技术及供应链的多维协同，通过多维协同、相互促进达到共振加强的效果，不断提升公司产品技术能力和客户服务能力，助力下游客户提升综合竞争力，更好的满足不断演进的 PCB 先进制造需求。

四、公司新产品的布局

2023 年，公司已完成压合系统、在线双面光学检查机等新产品的研发，进一步拓展了关键工序的覆盖，加上涂层刀具产品的引入，业务范围跨入真空压合设备、光学检测设备及材料领域，为公司开拓全流程一站式场景解决方案做有力铺垫。

另外，在已布局的工序及产品方面，公司持续推动跨越性升级，如十二轴机械钻孔机、四光束 CO₂ 激光钻孔机、应用 AOD 技术的 UV 激光钻孔机、十六倍密通用高精测试机等，为 PCB 行业提供效率更高、综合成本更低的降本增效或提质增效解决方案，助力下游客户提升综合竞争力。

五、海外市场情况

PCB 制造企业海外布局进展加速，特别是泰国、越南等东南亚地区诸多项目进入设备评估阶段，公司积极拓展海外市场，推进海外公司设立，建立本土化的运营团队，及时满足客户的购机或技术支援需求。目前已与从中国大陆出海到东南亚国家的多家 PCB 企业达成合作意向，随着下游客户东南亚项目的陆续落地，公司海外市场的销售额有望显著增长。

六、IC 封装基板领域进展

在 IC 封装基板领域，AI 高速数据处理芯片 2.5D/3D 先进封装推动封装基板朝着更高技术附加值方向发展。公司一直以来紧紧围绕国内封装基板龙头客户的需求进行产品研发，推出的高转速载板专用机械钻孔机获得国内多家龙头客户的认证，可满足 BT 载板及 FC-BGA 载板小孔径的高精度加工；创新运用新型激光技术，开发

	出用于玻璃基在内先进封装基板的加工方案，包括极小直径钻孔、盲槽及内埋高精度元器件锣槽等工艺的应用，广泛获得国内外封装基板厂商的技术认证及顶级终端客户的认可；研发的封装基板高精专用测试及 FC-BGA 单片测试设备，具备对标龙头企业 Nidec-Read 主流机型的能力。
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 6 月 4 日